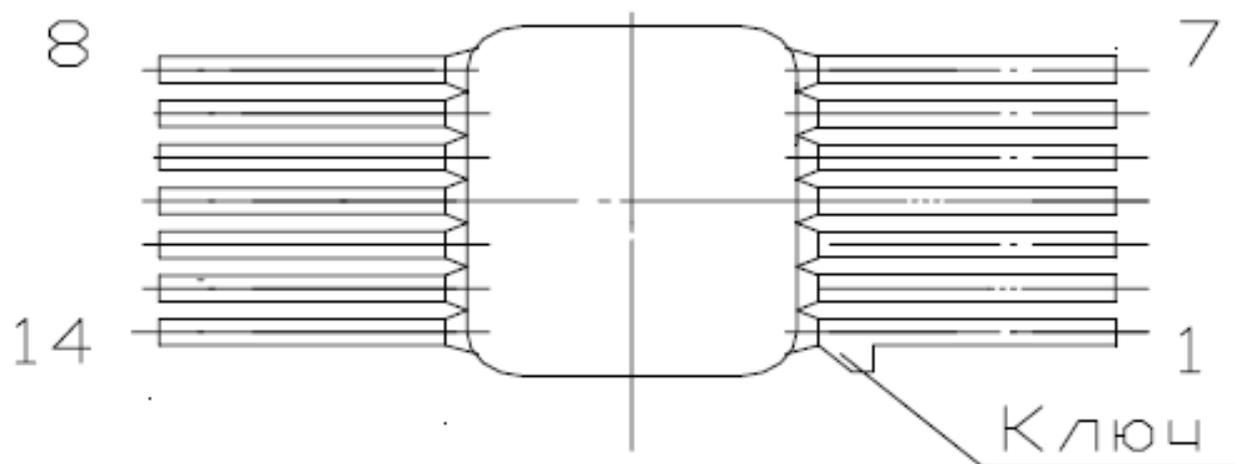


ЭТИКЕТКА

САРЛ.431130.030 ЭТ2

Микросхемы интегральные 198НТ2АТВК, 198НТ2БТВК, 198НТ2АТ1ВК, 198НТ2БТ1ВК, ОСМ198НТ2АТ1ВК, ОСМ198НТ2БТ1ВК – матрица транзисторов NPN типа.

Схема расположения выводов

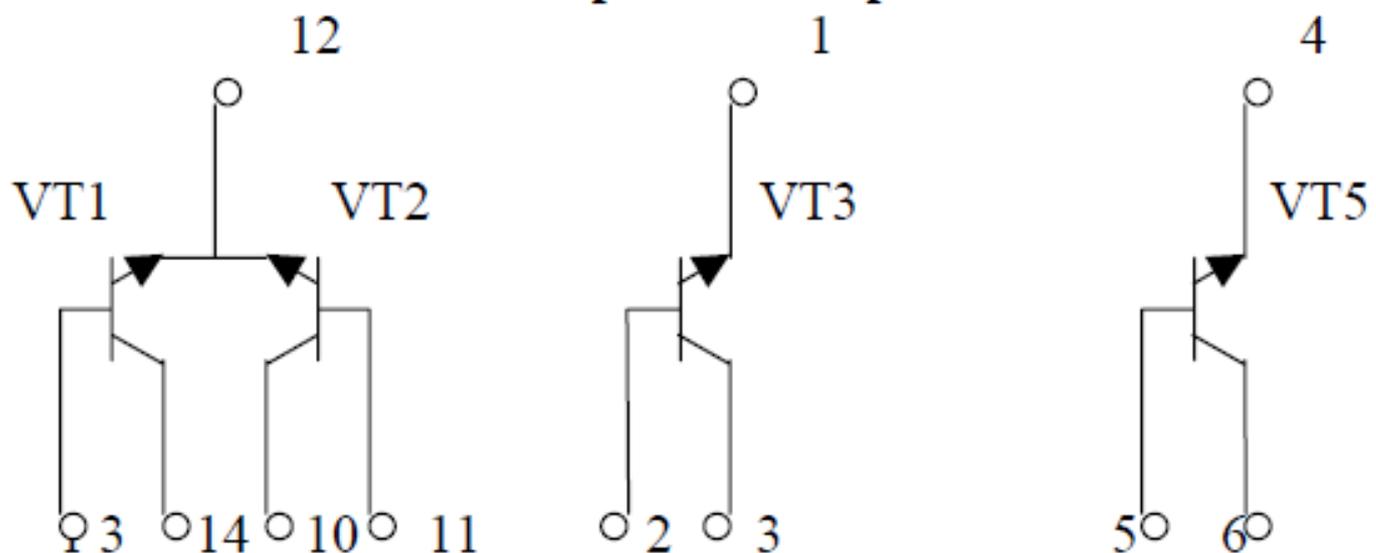


Нумерация выводов показана условно.

Ключ показывает начало отсчета выводов.

Масса не более 0,8 г.

Схема электрическая принципиальная



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
при температуре (25±5) °С

| Наименование параметра, единица измерения, режим измерения | Бук- вен- ное обоз- наче- ние | Норма | | | |
|---|--|---|-------------|---|-------------|
| | | 198НТ2АТВК 198НТ2АТ1ВК ОСМ198НТ2АТ1ВК | | 198НТ2БТВК 198НТ2БТ1ВК ОСМ198НТ2БТ1ВК | |
| | | не менее | не более | не менее | не более |
| Статический коэффициент передачи тока при: $U_{CB} = -3$ В; $I_E = -0,5$ мА | h_{21E} | 30 | 200 | 30 | 200 |
| Обратный ток эмиттера, нА | I_{EBO} | - | 100 | - | 100 |
| Обратный ток коллектора, мкА, при: $U_{CB} = 6$ В | I_{CBO} | - | 0,05 | - | 0,05 |
| Напряжение насыщения база-эмиттер, В, при: $I_C = 3$ мА; $I_B = 0,5$ мА | U_{BEsat} | - | 0,8 | - | 0,8 |
| Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В, при: $I_C = 3$ мА; $I_B = 0,5$ мА | U_{CEsat} | - | 0,2 | - | 0,2 |
| Разброс статических коэффициентов передачи тока (транзисторов VT1 VT2) ,%, при: $U_{CB} = 3$ В; $I_B = -0,5$ мА | Δh_{21E} | - | 15 | - | 15 |
| Разброс напряжения база- эмиттер (транзисторов VT1 VT2), мВ, при: $U_{CB} = 3$ В; $\Sigma I_E = 0,5$ мА | ΔU_{BE} | - | 3 | - | 10 |
| Ток утечки, нА | I_L | - | 50 | - | 50 |

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. микросхем:
- золото

Цветных металлов не содержится.

НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка ($T_{нм}$) микросхем в режимах и условиях допускаемых ТУ, - 100000 ч, а в следующих облегченных режимах при напряжениях, токах и мощностях, не превышающих 60 % от предельных значений – 120000 ч.

Гамма-процентный ресурс ($T_{гр}$) микросхем при $\gamma=95\%$ 200000 ч

Минимальный срок сохраняемости микросхем ($T_{см}$) при их хранении:

- в отапливаемом хранилище или в хранилище с регулируемой влажностью и температурой или местах хранения микросхем, смонтированных в защищенную аппаратуру, или находящихся в защищенном комплекте ЗИП, - 25 лет;
- в неотапливаемом хранилище – 16,5 лет;
- под навесом и на открытой площадке, смонтированными в аппаратуру (в составе незащищенного объекта), или в комплекте ЗИП – 12,5 лет.

Срок сохраняемости исчисляется с даты изготовления, указанной на микросхеме.